# **Generate Collection**

L10: Entry 1 of 2

File: JPAB

Nov 4, 1994

PUB-NO: JP406310748A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06310748 A

TITLE: SOLAR CELL MODULE

PUBN-DATE: November 4, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ISHIKAWA, ATSUO

ENDOU, TOSHITO

YAMAGISHI, HIDEO

NODA, KOJI

ISURUGI, MASAKAZU

IZUMINA, MASANOBU

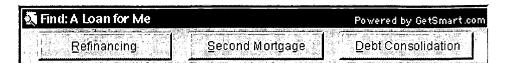
INT-CL (IPC): H01L 31/042

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a large scale solar cell module which can be manufactured at low cost while keeping high reliability.

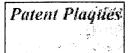
CONSTITUTION: A first electrode layer of conductive metal oxide, an amorphous semiconductor layer, a second electrode layer of metal, and at least one of a dielectric layer 6 or a sealing resin layer 7 having principal chain skeleton of polyisobuthylene are laminated sequentially on a trans parent substrate of tempered glass or laminated glass.

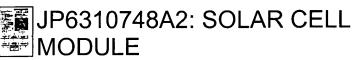
COPYRIGHT: (C) 1994, JPO





Home | Search | Order | Shopping Cart | Login | Site Map | Help





View Images (1 pages) | View INPADOC only

Country: JP Japan

Kind:

Inventor(s): ISHIKAWA ATSUO

ENDOU TOSHITO YAMAGISHI HIDEO NODA KOJI

ISURUGI MASAKAZU IZUMINA MASANOBU

Applicant(s): KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Issued/Filed Dates: Nov. 4, 1994 / Nov. 12, 1992

Application Number: JP1992000328490

IPC Class: H01L 31/042;

Priority Number(s): Oct. 14, 1992 JP1992000303070

Abstract: Purpose: To provide a large scale solar cell module which can be

manufactured at low cost while keeping high reliability.

**Constitution**: A first electrode layer of conductive metal oxide, an amorphous semiconductor layer, a second electrode layer of metal, and at least one of a dielectric layer 6 or a sealing resin layer 7 having principal chain skeleton of polyisobuthylene are laminated sequentially on a trans parent substrate of tempered glass or

laminated glass.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO

Other Abstract Info: CHEMABS 122(14)165556M CAN122(14)165556M DERABS G95-026338

DERG95-026338

Foreign References: (No patents reference this one)

Powered by DB2 and Net.Data

Alternative Searches







Nominate this invention

**Browse** 









# End of Result Set

**Generate Collection** 

L10: Entry 2 of 2

File: DWPI

Nov 4, 1994

DERWENT-ACC-NO: 1995-026338

DERWENT-WEEK: 199504

COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Solar battery manufacturing method - using amorphous silicon as semiconductor material and layering it on reinforced glass substrate

PRIORITY-DATA:

1992JP-0303070

October 14, 1992

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 06310748 A

November 4, 1994

N/A

007

H01L031/042

INT-CL (IPC): H01L 31/042

ABSTRACTED-PUB-NO: JP06310748A

BASIC-ABSTRACT:

On a transparent substrate (1) of reinforced glass, a conductive metal oxide layer (2) is formed. Over this, an amorphous semiconductor layer (3), a metal layer and an insulation layer (6) are formed one after the other.

The arrangement is sealed with a poly-isobutylene sealing layer (7) and this constitutes the solar battery module. This is mounted on a frame (8) using an adhesive (14).

ADVANTAGE - Provides high reliability. Provides solar battery at low cost with high efficiency.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-310748

(43)公開日 平成6年(1994)11月4日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01L 31/042

7376-4M

H01L 31/04

R

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-328490

(22)出願日

平成 4年(1992)11月12日

(31)優先権主張番号 特顯平4-303070

(32)優先日

平 4 (1992)10月14日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(72)発明者 石川 敦夫

兵庫県明石市鳥羽363シティコート西明石

(72)発明者 円藤 俊人

兵庫県明石市太寺 4丁目12-20メロディー

ハイム太寺101

(72)発明者 山岸 英雄

兵庫県神戸市須磨区北落合1-1

(72)発明者 野田 浩二

兵庫県神戸市垂水区小東山6丁目11-21

(74)代理人 弁理士 柳野 隆生

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 太陽電池モジュール

(57)【要約】

(修正有)

【目的】高い信頼性を維持しながら安価に製造可能とな る大型の太陽電池モジュールを提供する。

【構成】強化ガラスまたは貼り合わせガラス等の透明基 板上に、導電性金属酸化物等の第1の電極層と、非晶質 半導体層と、金属等の第2の電極層と、少なくとも絶縁 体層6と、主鎖骨格がポリイソブチレンである封止樹脂 層7のどちらか一方とが順次積層されていることを特徴 としている。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】ガラス基板上に形成された非晶質半導体太陽電池モジュールであって、強化ガラスまたは貼り合わせガラスと、導電性金属酸化物層と、非晶質半導体層と、金属層と、絶縁体層と、封止樹脂層とが順次積層されていることを特徴とする太陽電池モジュール。

【請求項2】ガラス基板上に形成された非晶質半導体太陽電池モジュールであって、強化ガラスまたは貼り合わせガラスと、導電性金属酸化物層と、非晶質半導体層と、金属層と、絶縁体層または封止樹脂層の一方とが順次積層されていることを特像とする太陽電池モジュール。

【請求項3】前記絶縁体層に酸化珪素を含む層を用いたことを特徴とする、請求項1または2記載の太陽電池モジュール。

【請求項4】前記絶縁体層が0.01μm以上の厚みを有する事を特徴とする、請求項3記載の太陽電池モジュール.

【請求項5】前記封止樹脂層の硬化後における水蒸気透過率が、 $100\mu$ mの層厚において1g $/m^2$ ・day以下であることを特徴とする、請求項1または2記載の太陽電池モジュール。

【請求項6】前記封止樹脂層が層厚0.05mm以上のポリイソブチレン系樹脂であることを特徴とする、請求項5記載の太陽電池モジュール。

【請求項7】受光面の面積が0.1 m<sup>2</sup> 以上であることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。

【請求項8】透明基板上に、第1の電極層、非晶質半導体層、第2の電極層、封止樹脂層を順次積層することにより形成された太陽電池モジュールにおいて、前記封止樹脂層の主鎖骨格がポリイソブチレンであることを特徴とする太陽電池モジュール。

## 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、大型の非晶質半導体太陽電池モジュールに関し、太陽電池全体が簡易な方法で封止でき、しかも強度面で優れている非晶質半導体太陽電池モジュールに関するものである。

## [0002]

【従来の技術】アモルファスシリコンをはじめとする非晶質半導体太陽電池は、結晶半導体太陽電池と比較して基板の選択自由度が高く、ガラス基板や金属基板、樹脂基板等の上に比較的低温で容易に形成し得るという特徴を有している。このため比較的小型の太陽電池モジュールは、ガラス基板上に導電性金属酸化物層、非晶質半導体層、金属層を形成し、シート状の樹脂を接着剤層を挟んで真空ラミネートによって封止して形成されている。

【0003】一方本発明の対象となる大型の太陽電池モジュールについては、強度面での補強が必要であり、強

化ガラスあるいは合わせガラス上に、ガラス基板上に導電性金属酸化物層、非晶質半導体層、金属層を形成したいわゆる太陽電池サブモジュールを複数枚並べ、電気的な接続を行った後、シート状の樹脂で挟んで封止することにより形成されている。図6には従来技術における大型のアモルファスシリコン太陽電池モジュールの一例を、断面構造図として示す。本図の例は、従来から一般的に用いられている、スーパーストレート方式による一般のであり、白板強化ガラス1とエチレンビニルアセテートなどの充填材11により、銅箔13などで電気的に接続した複数枚の太陽電池サブモジュール10、10・・を封止し、アルミニウム箔サンドイッチ形フッ化ビニルフィルム12などを保護膜として積層したものである。充填材11による太陽電池サブモジュール10の封止は、通常真空ラミネート法が用いられている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、大型の 太陽電池モジュールを形成する場合、太陽電池サブモジ ュールの形成工程の他に、強化ガラス上への太陽電池サ ブモジュールの配置、電気的接続、真空プロセスによる ラミネートなど工数が多いことに加え、ラミネート装置 等の高価な真空装置を必要とし、製品単価が上昇してし まうという価格上の問題点と、ラミネート時の充填材中 への気泡の混入などの品質上の問題点があった。更に は、サブモジュール間に間隙が生じるため、モジュール 効率が低下するという特性上の問題点もあった。即ち、 従来技術においては、本来低コスト化に有利なアモルフ アスシリコンを用いているにも係わらず、強度上の要請 から強化ガラスや貼り合わせガラスにより補強しなけれ ばならず、安価な太陽電池モジュールが提供できないと いうコスト上の欠点、製造工程において充填材中に気泡 が混入し、信頼性をも低下させてしまうという品質上の 欠点、モジュール効率の低下という性能上の欠点を有し ていた。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は上述の問題点に鑑みて案出されたものであり、大型の非晶質半導体太陽電池モジュールが、高い信頼性を維持しながら安価に製造可能となるものであり、その特徴とするところは、第1の発明においては、ガラス基板上に形成された非晶質半導体太陽電池モジュールであって、強化ガラスまたは貼り合わせガラスと、導電性金属酸化物層と、非晶質半導体層と、金属層と、絶縁体層と、対止樹脂層とが順度、、絶縁体層または封止樹脂層の一方とが順次積層されているところにあり、前記絶縁体層が0.01μm以上の厚みを有する酸化珪素を含む層であることや、前記封止樹脂層の硬化後における水蒸気透過率が、100μmの層厚において1g/m²・day以下であって、層厚0.

 $0.5 \, \mathrm{m} \, \mathrm{m}$ 以上のポリイソブチレン系樹脂であることが併せて考慮される。またこのような課題解決手段は、特に受光面の面積が $0.1 \, \mathrm{m}^2$ 以上である太陽電池モジュールに対して有効である。

【0006】また第2の発明の特徴とするところは、透明基板上に、第1の電極層、非晶質半導体層、第2の電極層、封止樹脂層を順次積層することにより形成された太陽電池モジュールにおいて、前記封止樹脂層の主鎖骨格がポリイソブチレンであるところにある。

# [0007]

【作用】本発明の太陽電池モジュールは、強化ガラスまたは貼り合わせガラスまたはその他透光性基板上に直接非晶質半導体による太陽電池を形成し、酸化珪素を含む絶縁体層や、主鎖骨格がポリイソブチレンである水蒸気透過率の低い封止樹脂層を設けることにより、裏面を保護するものである。

# [0008]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。 図1は本発明の太陽電池モジュールの一実施例の概略図である。図中1はガラス基板、5は導電性金属酸化物層、非晶質半導体層、金属層を順次積層した太陽電池素子、6は絶縁体層、7は封止樹脂層をそれぞれ示す。導電性金属酸化物層としては従来の太陽電池モジュールと同様に酸化錫や酸化インジウム錫が用いられる。非晶質半導体層としては、アモルファスシリコンが、金属層としては、クロムとアルミニウムの積層構造などが用いられる。

【0009】ガラス基板1としては強化ガラスや貼り合わせガラス、またはその他一般的な透明基板が用いられ、ガラス成分が溶出しないよう、必要に応じて酸化珪素などを被着したものを用いても良い。

【0010】絶縁体層6としては、高温多湿下の条件で も酸素による金属層の腐食を防止するため、酸素透過率 が少なくアモルファスシリコンの成膜温度以下の低温で 作製できる酸化珪素を用いるのが適しており、膜厚とし ては0.01μm以上が良く、さらには0.05μm以 上が好適である。また作製方法としては、スパッタリン グ法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、光CVD 法、スピンオン法などが用いられるが、これら以外にも ディップ法、スプレイ法などの方法が可能であり、0. 01μm以上の膜厚であれば、酸素透過率として0.0 1 (cc·mm/m<sup>2</sup>·day·atm)程度となり、 期待する遮蔽効果が得られる。一方1 µ m以上の膜厚で は、膜厚の増加に対して酸素透過率が飽和してしまうた め、この膜厚以下に設定すれば充分である。また本絶縁 体層は、太陽電池素子が形成された後に成膜されるた め、成膜温度としては太陽電池の作製温度以下である2 00℃以下が良く、さらには150℃以下が好適であ

【0011】封止樹脂層7としては、本出願人によって

特開平3-140316号に示された、ポリイソブチレン系樹脂が用いられる。これについても前記絶縁体層6と同様に、高温多湿下の条件でも金属層の腐食を防止するためであり、水蒸気の遮蔽効果を有するものである。この封止樹脂層7の水蒸気透過率は200 $\mu$  mの膜厚において0.1 ( $g/m^2$ ・day)程度であり、膜厚としては、0.05 mm以上が良く、さらには0.1 mm以上1.0 mm以下が好適である。またシリカ、二酸化チタン、カーボンブラック、タルク等の充填剤を添加することも可能である。

【0012】以下、第1発明の実施例についてさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例により、何ら制限されるものではない。

【0013】 [実施例1] 図2 (a) において厚さ3. 2 mm、440mm×150mmの大きさの熱風冷強化 を行って作製した強化ガラス1上に、熱CVD法により 導電性酸化物層として酸化錫層2を約500nm形成し た後、同図 (b) に示す如く、波長1.06 µmのYA Gレーザーの基本波を用いて、単位素子の幅が1cmと なるように電気的に分離した。この時の隣接する酸化錫 層間の抵抗値としては、いづれも1ΜΩ以上であった。 その後純水で超音波洗浄を行い、同図(c)に示す如く 酸化錫層2が被着された面側に、基板温度200℃、反 応圧力0.5~1.0Torrにてモノシラン、メタ ン、ジボランからなる混合ガス、モノシラン、水素から なる混合ガス、モノシラン、ホスフィン、水素からなる 混合ガスをこの順に容量結合型グロー放電分解装置内で 分解することにより、非晶質半導体層3として、p型非 晶質シリコン半導体層、 i 型非晶質シリコン半導体層、 およびn型微結晶シリコン半導体層をそれぞれの膜厚が 15 nm、450 nm、300 nmとなるように形成し た。冷却後酸化錫層の分離部分より50μmずらして、 図3 (d) に示す如くp-i-n非晶質シリコン半導体 層3を、酸化錫層2にダメージがないように、波長0. 53μmのYAGレーザーの第2高調波を用いて分離し た。その後電子ビーム蒸着により、同図 (e) に示す如 く、金属層としてアルミニウムを250mmの膜厚に形 成して裏面電極4とした。試料を蒸着装置から取り出し た後、同図 (f) に示す如く、非晶質シリコン半導体層 の分離部分よりさらに 5 0 μ m ずらして、非晶質シリコ ン半導体層3と酸化錫層2にダメージがないように、裏 面電極層4を波長0.53μmのΥΑGレーザーの第2 高調波を用いて除去し、集積型非晶質シリコン太陽電池 を作製した。これらのレーザースクライブによる分離幅 は、酸化錫層、非晶質シリコン半導体層、裏面電極層で それぞれ約50、150、150μmであった。

【0014】このようにして得られた太陽電池を、エアマス1.5、100mw/cm²の擬似太陽光の照射下で測定したところ、約4Wの出力が確認された。この太陽電池の裏面電極4に、耐熱ポリエステルテープを用い

てリード線取り出し部のみをマスキングし、酸化珪素を ターゲットとしてスパッタリングを行い、絶縁体層6を 形成した。スパッタリング条件としては、交流スパッタ リング方式で13.56MHz、基板温度は室温であ り、反応圧は1.2 torr、アルゴンガス流量は20 sccm、投入パワーは100wであり、5分の成膜時 間で、40nmの膜厚を得た。さらにポリイソブチレン を主剤とする樹脂層を塗布形成し、130℃で約2時間 熱硬化後、膜厚200μmの封止樹脂層7を得た。電極 取り出し部の樹脂を取り除いた後、半田によってリード 線を取り出し、樹脂を除去した部分にポリイソブチレン を更に塗布し、130℃で2時間熱硬化を行った。冷却 後、このようにして作製した太陽電池パネルPの端面 を、ブチルゴム系の接着剤14を用いてアルミニウムの フレーム8に嵌着固定し、図1に示す如き太陽電池モジ ュールを完成させた。この太陽電池モジュールを、エア マス1. 5、100mw/cm²の疑似太陽光の照射下 で測定したところ、4Wの出力が得られ、スパッタリン グ法による蒸着粒子のボンバードメントによる裏面電極 4の特性劣化が当初考えられたが、上記条件において は、特性劣化がみられず、スパッタリング並びにポリイ ソブチレン系樹脂の塗布によるプロセスでの特性劣化は 認められなかった。

【0015】 [実施例2] 実施例1と同様に、厚さ3.2mm、基板サイズ440×150mmの太陽電池を作製し、更に絶縁体層として酸化珪素膜を、スパッタリング法により成膜した。この後マスキングに用いたポリエステルテープを取り除き、半田によってリード線を取り出し、この後ポリイソブチレンをリード線取り出し部周辺の酸化珪素被膜のない部分に塗布し、130℃で約2時間熱硬化させた。冷却後、このようにして作製した太陽電池パネルの端面を、ブチルゴム系の接着剤を用いてアルミニウムのフレームに嵌着固定し、太陽電池モジュールを完成させた。この太陽電池モジュールをエアマス1.5、100mw/cm²の疑似太陽光下で測定したところ、4Wの出力が得られた。

【0016】〔実施例3〕実施例1と同様に、厚さ3.2mm、基板サイズ440×150mmの太陽電池を作製し、更に絶縁体層として酸化珪素膜を、EB蒸着機を用いて酸素雰囲気中で50nmの膜厚に成膜した。この後ポリイソブチレンを主剤とする樹脂層を塗布形成し、130℃で約2時間熱硬化後、膜厚200μmの封止・樹脂層を得た。電極取り出し部の樹脂を取り除いた後、半田によってリード線を取り出し、樹脂を除去した部分にポリイソブチレンを更に塗布し、130℃で2時間熱硬化を行った。冷却後、このようにして作製した太陽電池パネルの端面を、ブチルゴム系の接着剤を用いてアルミニウムのフレームに嵌着固定し、太陽電池モジュールを完成させた。この太陽電池モジュールをエアマス1.5、100mw/cm²の疑似太陽光下で測定したとこ

ろ、4Wの出力が得られた。

【0017】 [比較例1] また5インチ×6インチのガ ラス基板上に、上記実施例1と同一方法により裏面電極 までを形成した太陽電池素子10を、実施例1と同様の 強化ガラス1上に、厚み600μmのエチレンビニルア セテート (EVA) フィルム11、太陽電池素子10、 同EVAフィルム11、アルミニウム箔をサンドイッチ したポリフッ化ビニル樹脂 (PVF) フィルム (PVF 38μm/アルミニウム箔30μm/PVF38μm) 12の順に積層し、ラミネート法を用いて真空中で加熱 するとともに架橋処理を行い、出力リード線を基板の外 部に取り出し、太陽電池パネルPとした。このようにし て作製した太陽電池パネルPの端面を、ブチルゴム系の 接着剤14を用いてアルミニウムのフレーム8に嵌着固 定し、太陽電池素子間を銅箔で接続していないこと以外 は、図6に従来例として示したものと同一構造の太陽電 池モジュールを完成させた。

【0018】また、上記3つの実施例において基板サイズを5インチ×6インチ、強化ガラスの厚みを1.1mmとした太陽電池モジュールを、各実施例につきそれぞれ5個ずつ作製した。この太陽電池モジュールの信頼性を評価するために、槽内温度127℃、槽内圧力2気圧、相対湿度85%R.H.としたプレッシャークッカー試験を500時間行った。図4には本試験500時間後における最大出力を、初期値で規格化したものの度数分布を示している。図中縦軸は本試験に供した太陽電池モジュールの初期変換効率に対する、試験後の変換効率をそれぞれ表している。また図5には、本試験500時間までの平均変換効率の変化を、初期値で規格化したものを示している。

【0019】図4、図5により明らかなように、本発明の太陽電池モジュールにおいては、電子部品に対して極めて過酷なプレッシャークッカー試験においても、実施例2において若干の出力低下が見られるものの、500時間後における出力の劣化は殆ど問題なく、従来技術に比べて信頼性の向上していることがわかる。実施例2に見られる出力の低下も、試験条件を考慮すると実際の屋外暴露では大きな劣化には至らないと考えられる。

【0020】上述の実施例では、絶縁体層と封止樹脂層 を両方用いたものと、絶縁体層のみを用いたものを示し たが、封止樹脂層のみとすることもできる。

【0021】 さらに第2の発明についても、具体的実施例に基づいて、以下にその詳細を説明する。図2(a) と同様に厚さ3.2 mm、440 mm×150 mmの大きさの青板ガラス上に、熱CVD法により第1 の電極層として酸化錫層を約500 n m形成した後、図2(b) と同様に、波長1.06  $\mu$  mのYAG レーザーの基本波を用いて、単位素子の幅が1 c m となるように電気的に分離した。この時の隣接する酸化錫層間の抵抗値として

は、いづれも1ΜΩ以上であった。その後純水で超音波 洗浄を行い、図2 (c) と同様に酸化錫層が被着された 面側に、基板温度200℃、反応圧力0.5~1.0T orrにてモノシラン、メタン、ジボランからなる混合 ガス、モノシラン、水素からなる混合ガス、モノシラ ン、ホスフィン、水素からなる混合ガスをこの順に容量 結合型グロー放電分解装置内で分解することにより、非 晶質半導体層として、p型非晶質シリコン半導体層、i 型非晶質シリコン半導体層、およびn型微結晶シリコン 半導体層をそれぞれの膜厚が15nm、450nm、3 00nmとなるように形成した。冷却後酸化錫層の分離 部分より50 $\mu$ mずらして、図3(d)と同様にp-i-n 非晶質シリコン半導体層を、酸化錫層にダメージが ないように、波長0.53μmのΥΑGレーザーの第2 高調波を用いて分離した。その後電子ビーム蒸着によ り、図3 (e) と同様に、第2の電極層としてアルミニ ウムを250nmの膜厚に形成して裏面電極とした。試 料を蒸着装置から取り出した後、図3 (f)と同様に、 非晶質シリコン半導体層の分離部分よりさらに50 µ m ずらして、非晶質シリコン半導体層と酸化錫層にダメー ジがないように、裏面電極層を波長0.53μmのYA Gレーザーの第2高調波を用いて除去し、集積型非晶質 シリコン太陽電池を作製した。これらのレーザースクラ イブによる分離幅は、酸化錫層、非晶質シリコン半導体 層、裏面電極層でそれぞれ約50、150、150μm であった。

【0022】このようにして得られた太陽電池を、エア マス1. 5、100mw/cm²の擬似太陽光の照射下 で測定したところ、約4Wの出力が確認された。この太 陽電池の裏面電極上に主鎖骨格がポリイソブチレンであ る樹脂層を塗布形成し、130℃で約2時間熱硬化後、 膜厚200μmの封止樹脂層を得た。電極取り出し部の 樹脂を取り除いた後、半田によってリード線を取り出 し、樹脂を除去した部分に前記ポリイソブチレン樹脂を 更に塗布し、130℃で2時間熱硬化を行った。冷却 後、このようにして作製した太陽電池パネルの端面を、 ブチルゴム系の接着剤を用いてアルミニウムのフレーム に嵌着固定し、図1に示す如き太陽電池モジュールを完 成させた。この太陽電池モジュールを、エアマス1. 5、100mw/cm<sup>2</sup>の疑似太陽光の照射下で測定し たところ、4Wの出力が得られ、ポリイソブチレン樹脂 の塗布によるプロセスでの特性劣化は認められなかっ

【0023】上述の第2の発明は、前述の第1の発明における実施例1として示した例の基板を青板ガラスとし、加えて裏面をポリイソブチレン樹脂のみで被覆したものであるが、第1の発明と同様、信頼性を評価するため槽内温度127℃、槽内圧力2気圧、相対湿度85% R. H. としたプレッシャークッカー試験を500時間行ったが出力の低下は見られず、第1の発明における実

施例1と全く同様の経時変化となった。

#### [0024]

【発明の効果】以上のように本発明においては、強化ガラスや貼り合わせガラス、またはその他の透光性基板の上に直接非晶質の太陽電池を形成したことにより、従来のように複数のサブモジュールを並べる必要がなくなり、安価でモジュール効率の高い太陽電池モジュールが実現できる。また、従来のエチレンビニルアセテートなどの充填材に代わり、酸化珪素を含む絶縁体層や、水蒸気透過率の低い主鎖骨格がポリイソブチレンである封止樹脂層を用いたことにより、従来見られた充填材中への気泡の混入等、品質上の問題点が無くなるとともに、酸素や水蒸気の遮蔽効果が向上した結果、極めて信頼性に優れた非晶質太陽電池モジュールを実現できる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における太陽電池モジュールの断面構造 を表す説明図

【図2】アモルファスシリコン太陽電池素子の製造工程 を表す説明図で(a)は導電性金属酸化物層の成膜後、

(b) は導電性金属酸化物層の分離後、(c) は非晶質 半導体層の成膜後をそれぞれ表している

【図3】アモルファスシリコン太陽電池素子の製造工程 を表す説明図で(d)は非晶質半導体層の分離後、

(e) は金属層の成膜後、(f) は金属層の分離後をそれぞれ表している

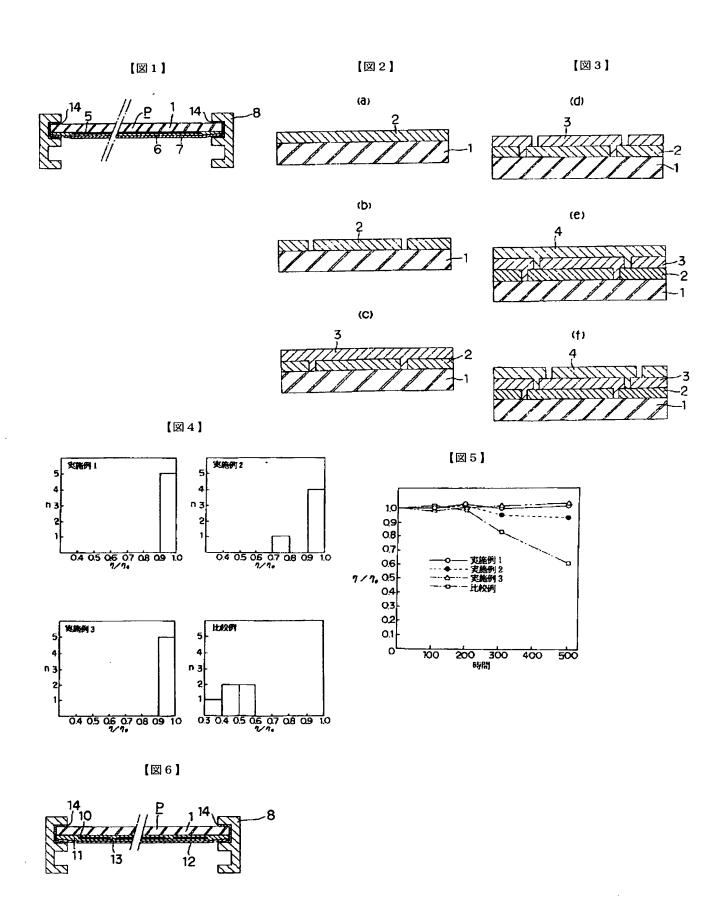
【図4】本発明の実施例および比較例における太陽電池 モジュールに、プレッシャークッカー試験を行った場合 の、試験前後の特性変化をヒストグラムにより表した説 明図

【図5】本発明の実施例および比較例における太陽電池 モジュールに、プレッシャークッカー試験を行った場合 の特性変化をグラフにより表した説明図

【図 6 】従来技術における太陽電池モジュールの断面構造を表す説明図

# 【符号の説明】

- 1 強化ガラス、青板ガラス
- 2 酸化錫層
- 3 アモルファスシリコン層
- 4 裏面電極層
- 5 強化ガラス上に形成した太陽電池
- 6 絶縁体層
- 7 封止樹脂層
- 8 フレーム
- 10 太陽電池サブモジュール
- 1 1 充填材
- 12 フッ化ビニルフィルム
- 13 銅箔
- 14 ブチルゴム系接着剤
- P 太陽電池パネル



フロントページの続き

(72) 発明者 石動 正和 京都府京都市北区小山堀池町28-16 (72)発明者 泉名 政信 埼玉県大宮市堀の内町1-60-1